

SUBSTRATE ASSEMBLING DEVICE

Patent Number: JP5154923

Publication date: 1993-06-22

Inventor(s): YONEDA FUKUO; others: 03

Applicant(s): HITACHI LTD; others: 01

Requested Patent: JP5154923

Application Number: JP19910323138 19911206

Priority Number(s):

IPC Classification: B29C65/78 ; B29C65/48 ; B41F17/14 ; G02F1/13

EC Classification:

Equivalents: JP2609386B2

Abstract

PURPOSE: To obtain a device, by which substrates can be pasted together with sealant with no introduction of dust during assembling work.

CONSTITUTION: A table 4, which travels between sealant drawing station S1 and substrate pasting station S2, is provided. Further, first substrate 13 is mounted on a stage 5, which travels on the table 4 normal to the travelling direction of the table 4, so as to emit sealant from an emitter, on which a downward directing nozzle tip is provided, and simultaneously move the stage to normal direction in order to draw pattern in S1. Second substrate 14 is horizontally hung with suction table 15 in S2. By moving the table 4 to S2, the first substrate is arranged below the second substrate. Finally, by narrowing the opposing interval between both the substrates, the substrates are pasted together.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

7

8

ための別置きの装置を必要とせず、装置構成を簡略化できる。

【0014】

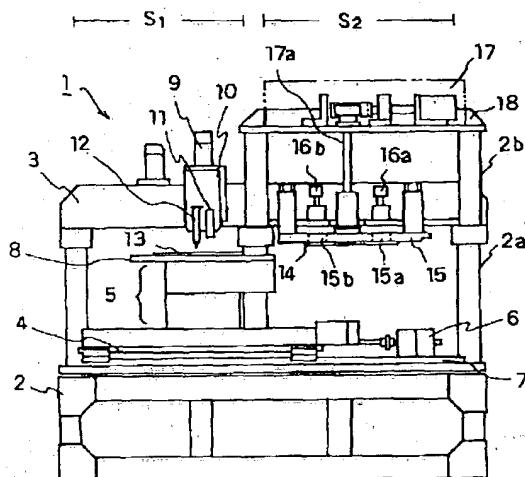
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、液晶表示パネルのように2枚の基板を接近させてシール剤で貼り合わせる基板組立装置での組立作業中に塵埃を取り込まずに貼り合わせることができ、また基板組立装置の構成を簡単にできる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明による基板組立装置の一実施例を示す液晶表示パネル組立装置の正面図

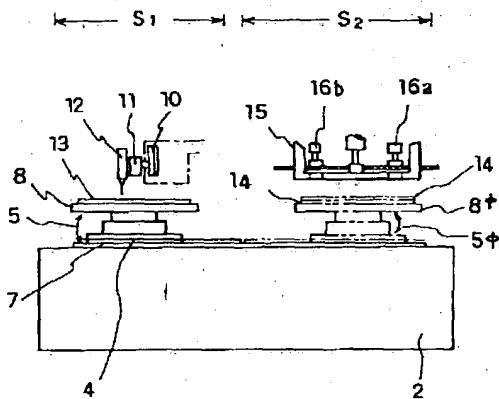
【図1】

【図1】本発明の一実施例を示す液晶表示パネル組立装置の正面図



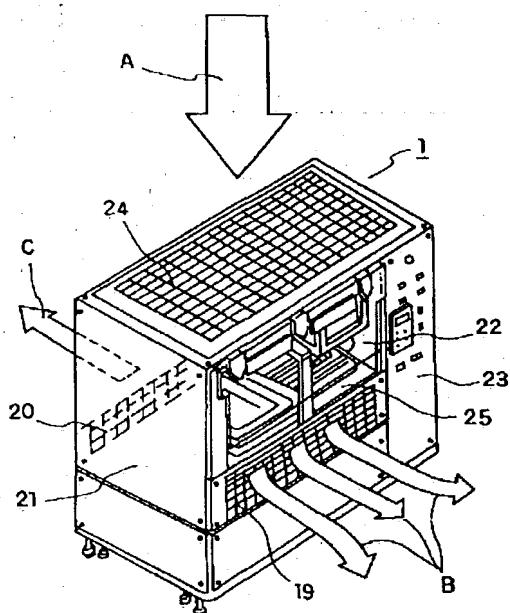
【図2】

【図2】図1の動作説明用の概略図



【図3】

【図3】図1の外観斜視図



フロントページの続き

(72)発明者 石田 茂

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ
クノエンジニアリング株式会社開発研究所
内

(72)発明者 三階 春夫

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ
クノエンジニアリング株式会社開発研究所
内

(72)発明者 近藤 克己

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日
立製作所日立研究所内